

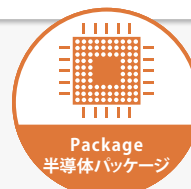
Molded Underfill(MUF) Semiconductor encapsulation Molding compounds

モールドアンダーフィル対応 半導体封止材



Applications 用途

Advanced IC Packages(Flip-chip package such as FC-CSP, FC-SiP module, etc.)
最先端半導体パッケージ (FC-CSP、FC-SiP モジュールなどのフリップチップパッケージ)



MUF materials realize underfilling to the narrow gap under flip-chip without void and overmolding the die at the same mold shot. Provide a better solution based on high loading technology of fine filler and resin design technology.

モールドアンダーフィル (MUF) 材により、フリップチップ下の狭ギャップ充填と全体封止をボイドレスで一括成形。
独自のファインフィラー高充填設計技術・樹脂設計技術により、最適な熱収縮を実現し、パッケージの低反り化に貢献。

Saving process time

工程時間短縮

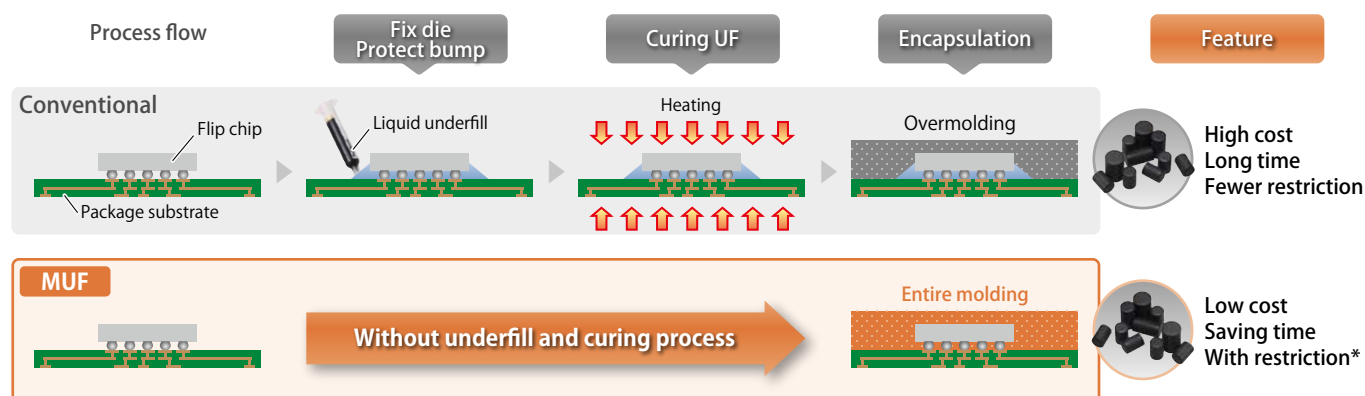
Excellent fillability for
Narrow gap/pitch

狭ギャップ/ピッチ充填

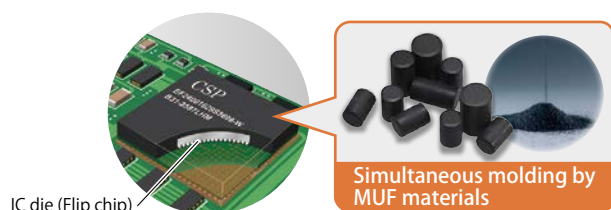
Low warpage

低反り

Process comparison プロセス比較

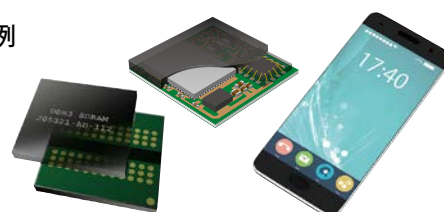


Excellent fillability for Narrow gap and Narrow pitch 狭ギャップ・狭ピッチ充填対応可能



Application 対応パッケージ例

Flip-chip package
- FC-CSP
- FC-SiP Module
Other



● We have various line-up of MUF materials proven for many packages.
Please contact us.

General properties 一般特性

Item	Unit	CV8710TAC	CV8710TLC	CV8710U	CV8715BU	X8710U-F1	CV8713
EMC type	—	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Filler cut point	μm	30		20		10	20
Flexural modulus (R.T.)	GPa	24	20	25	12	25	25
Tg (TMA)	°C	135	150	143	140	156	145
C.T.E.1	ppm/°C	10	13	10	21	10	10
Mold shrinkage	%	0.20	0.30	0.21	0.55	0.19	0.20

The above data are typical values and not guaranteed values. 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。